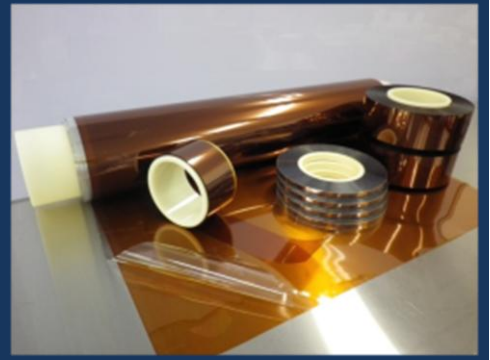


耐熱バックアップテープ KY シリーズ

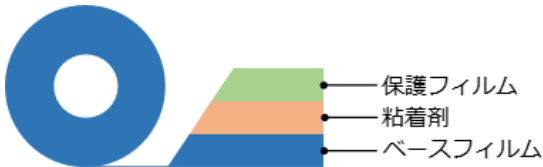
加熱処理工程のバックアップ/マスキング用途に最適な
ポリイミドベース微粘着テープ



【特長】

- ・ ベースフィルムにポリイミドフィルムを使用しているため耐熱性に優れる
(対ガラス 250℃×2分)
- ・ 加熱処理後の粘着力の上昇を抑え再剥離が可能
- ・ 再剥離後に糊残りを起こしにくく、被着材を汚染しない
- ・ 軽剥離で薄い材料の組み合わせに最適

【基本構成】



層名	種別	代表厚み
ベースフィルム	ポリイミド	50μm
粘着剤	アクリル系 微粘着剤	10μm
保護フィルム	PET	25μm

【特性例】

熱処理条件	粘着力 (N/cm)		糊残り	
	対ポリイミド	対ガラス	対ポリイミド	対ガラス
常温	0.02	0.02	なし	なし
160℃×3 時間	0.13	—	なし	—
250℃×2 分	—	0.02	—	なし

※ 上記データは参考値です。

問合せ先 河村産業株式会社 <http://www.kawamura-s.co.jp>
 本社・四日市工場 〒512-8052 三重県四日市市西大鐘町 330 番地 TEL (059) 337-1122
 東京支店 〒110-0005 東京都台東区上野 1-18-9 黒門平成ビル5 階 TEL (03) 5846-8228
 大阪営業所 〒532-0011 大阪市淀川区西中島 3-23-16 セントランドビル 4 階 D 室 TEL (06) 6476-7725